#### QSFP/QSFP+

TE 内部编号 2007626-1

TE 内部产品描述 1x4 QSFP Kit Assy Sqr LP, SAN Htsnk

#### 在 TE 官网查看>



连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子



插拔式 1/〇 产品类型: 壳体组件

可密封: 否

电路应用: Signal

工组温度范围: -55 - 105 °C [-67 - 221 °F]

数据速率(最大值): 14 Gb/s

# 产品特性

#### 产品类型特性

笼子类型	联动
包括热附件类型	散热器
插拔式 I/〇 产品类型	壳体组件
可密封	否
外形尺寸	QSFP+
结构特性 结构特性	
每个端口柱上的后部 EON 个数	1
端口数量	4
端口矩阵配置	1 x 4
电气特征	
数据速率(最大值)	14 Gb/s
主体特性	
散热器种类	插针
散热器表面涂层	阳极氧化黑色

6.5 mm[.256 in]

SAN

锡

散热器高度

接触件特性

散热器高度类

PCB 端子端接区域电镀材料



## 端接特性

 PCB 端接方法
 通孔 - 免焊连接

 端接柱体和尾部长度
 2.2 mm[.086 in]

#### 壳体特性

## 尺寸

PCB 厚度(建议) 1.45 mm[.057 in]

#### 使用环境

工组温度范围 -55 - 105 °C[-67 - 221 °F]

## 操作/应用

插拔式 I/O 应用 SFP+ 堆叠 Belly-to-Belly e路应用 Signal

## 行业标准

UL 阻燃性等级 UL 94V-0

#### 包装特性

封装方法 盒和托盘

#### 其他

# 产品合规性

如需合规文档,请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法(China RoHS 2,工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月(247) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月 (241) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号,产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%,镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号,产品均质材料中,铅、六价铬和汞的最大浓度不超过 0.1%,镉的最大浓度不超过 0.01%(按重量计算),或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规,TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的"物品中物质的要求指南",链接如下:https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

# 该系列中的其他产品 | QSFP/QSFP+









客户还购买了



## 文档

1x4 QSFP Kit Assy Sqr LP, SAN Htsnk

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2007626-1\_E.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2007626-1\_E.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2007626-1\_E.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款** 

1x4 QSFP Kit Assy Sqr LP, SAN Htsnk



产品规格

英文版本